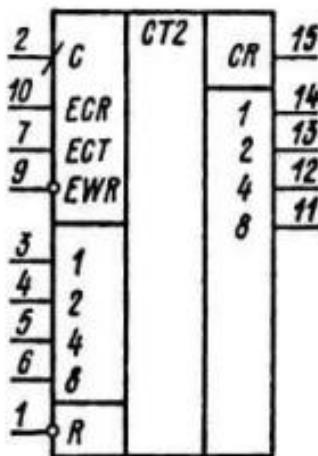


## **KP1533IE10, КФ1533IE10, ЭКФ1533IE10**

Микросхемы представляют собой двоичный счетчик с асинхронной установкой в состояние логического нуля. Корпус типа 238.16-1, масса не более 1,2 г, 4307.16-А.

Назначение выводов: 1 - вход установки в состояние «логического 0»  $\bar{R}$ ; 2 - вход тактовый С; 3 - вход информационный D1; 4 - вход информационный D2; 5 - вход информационный D4; 6 - вход информационный D8; 7 - вход разрешения счета ECT; 8 - общий; 9 - вход разрешения записи  $\bar{EWR}$ ; 10 - вход разрешения записи ECR; 11 - выход третьего разряда Q8; 12 - выход второго разряда Q4; 13 - выход первого разряда Q2; 14 - выход нулевого разряда Q1; 15 - выход переноса CR; 16 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение KP1533IE10, КФ1533IE10, ЭКФ1533IE10

### **Электрические параметры**

Номинальное напряжение питания ..... 5 В ± 10%

Выходное напряжение низкого уровня:

- при  $I_{\text{вых}}^0 = 4 \text{ мА}$  .....  $\leq 0,4 \text{ В}$
- при  $I_{\text{вых}}^0 = 8 \text{ мА}$  .....  $\leq 0,5 \text{ В}$

Выходное напряжение высокого уровня .....  $\geq 2,5 \text{ В}$

Ток потребления при  $U_n = 5,5 \text{ В}$  .....  $\leq 21 \text{ мА}$

Входной ток низкого уровня .....  $\leq |-0,2| \text{ мА}$

Входной ток высокого уровня:

- по выводам 2, 9, 10 .....  $\leq 40 \text{ мкА}$
- по выводам 1, 3, 4, 5, 6, 7 .....  $\leq 20 \text{ мкА}$

Время задержки распространения сигнала

при включении:

- от вывода 2 к выводу 15 .....≤ 23 нс
- от вывода 2 к выводам 11, 12, 13, 14 .....≤ 17 нс
- от вывода 10 к выводу 15 .....≤ 13 нс
- от вывода 1 к выводам 11, 12, 13, 14 .....≤ 24 нс
- от вывода 1 к выводу 15 .....≤ 28 нс

Время задержки распространения сигнала при выключении:

- от вывода 2 к выводу 15 .....≤ 26 нс
- от вывода 2 к выводам 11, 12, 15, 14 .....≤ 15 нс
- от вывода 10 к выводу 15 .....≤ 13 нс

Емкость входа .....≤ 5 пФ

### **Предельно допустимые режимы эксплуатации**

Напряжение питания .....	4,5...5,5 В
Входное напряжение низкого уровня .....	0...0,8 В
Входное напряжение высокого уровня .....	2...5,5 В
Максимальное напряжение, подаваемое на выход .....	5,5 В
Температура окружающей среды .....	-10...+70 °С

### **Общие рекомендации по применению**

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоеем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака  $65 \pm 5$  °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В  $\pm 10\%$ , к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.